

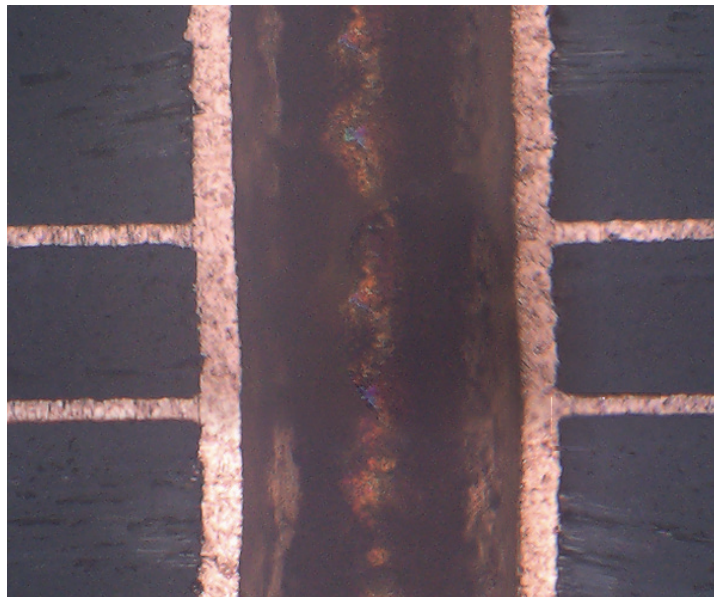
MacuSpec PPR 200

电镀铜金属化

包含在成本中的厚度均匀性

MacDermid Enthone MacuSpec PPR 200是值得全球制造商信赖的电镀工艺,这些制造商需要精确的厚度均匀性和传统酸性镀铜无法实现的整体生产力。旨在更有效地制造多层PCB,它可以轻松满足最具挑战性的电镀规范。

作为MacDermid Enthone系列电镀镀铜工艺的一部分,MacuSpec PPR 200在比传统直流方法更短的时间内提供更一致的电镀层,从而使用户能够提高整体产量。它可以在孔的中心电镀所需的厚度,同时在印刷电路板的表面电镀铜厚较少,大大减少了铜阳极和阻焊膜的消耗。均匀的铜分布可以减少干膜厚度,从而降低运营成本。MacuSpec PPR 200还可以同时成功地电镀上高纵横比的通孔和盲微孔,而无需多次电镀循环。它在电镀高纵横比通孔上的优越深镀能力可以减少高达70%的电镀时间。



主要特性优点

- 出色的厚度均匀性
- 可靠的热循环性能
- 出色的深镀能力:减少循环时间高达70%
- 减少铜阳极和阻焊膜的消耗
- 适合目前更厚的高密度面板
- 以最低的拥有成本实现高产量的生产力



MacDermid Enthone

MacuSpec PPR 200

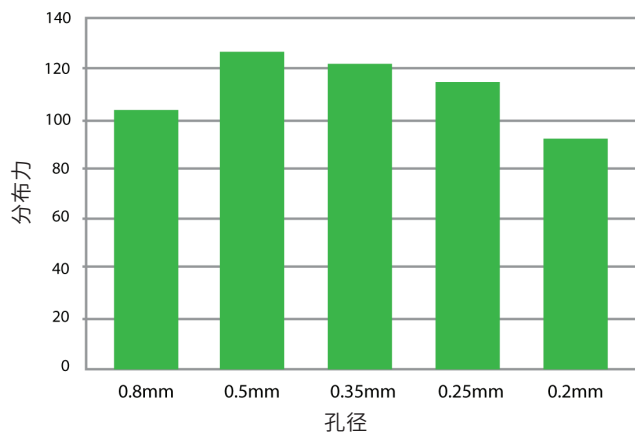
电镀铜金属化

缩短循环时间的同时实现电镀目标

MacDermid Enthone是电镀技术的领导者,提供MacuSpec PPR 200和PPR 100作为制造商的最佳解决方案,这些制造商需要以尽可能低的成本实现厚度均匀性。MacuSpec PPR 200具有出色的均镀能力,可用于盲微孔和高纵横比孔,是传统酸性镀铜的完美的替代品。

分布力

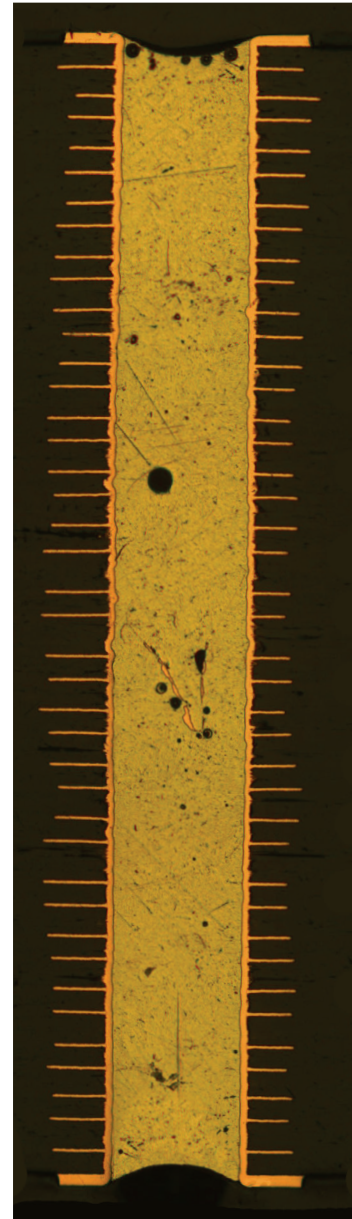
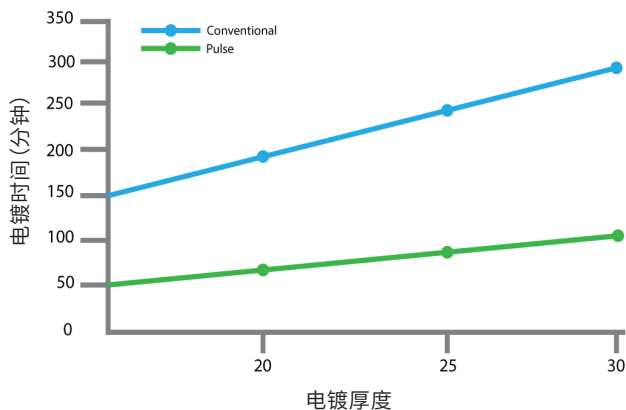
板厚的微观分布



生产力

循环时间 vs 电镀厚度

(3.2 mm, 13:1 纵横比 PTH)



macdermidalpha.com
October, 2019

MacDermid Enthone is a product brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions.

© 2019 MacDermid, Inc. and its group of companies. All rights reserved.

® and ™ are registered trademarks or trademarks of MacDermid, Inc. and its group of companies in the United States and/or other countries.